



2024年3月期 第2四半期

(2023年4月1日 ~ 2023年9月30日)

# 決算補足資料

**ENOMOTO Co.,Ltd.**

東証プライム 証券コード:6928

- (1) 2024年3月期決算第2四半期決算 P.3
- (2) 2024年3月期業績予想 P.10

# (1) 2024年3月期第2四半期決算



- ・ 円安が増収要因となったものの、中国経済の停滞及び欧米のインフレによる世界的な個人消費の低迷から民生用機器を中心に在庫調整が継続し減収
- ・ 生産能力増強に伴う減価償却費や人財の採用などの先行投資により、営業利益は大幅減益

単位:百万円	2023/3期 2Q累計		2024/3期 2Q累計		期比較	
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前同比(%)	前同比増減
売上高	14,650	100.0	13,020	100.0	△11.1	△1,629
売上総利益	2,173	14.8	1,364	10.5	△37.2	△808
販管費	1,234	8.4	1,227	9.4	△0.6	△6
営業利益	938	6.4	137	1.1	△85.4	△801
為替差損益	138	-	29	-	-	△109
経常利益	1,127	7.7	190	1.5	△83.1	△937
四半期純利益	778	5.3	87	0.7	△88.8	△690
1株当たり 四半期純利益	116.58円	-	13.10円	-		

- 需要は前期4Q比で底打ちしたものの全体的な回復は後倒しとなり、ほぼ横ばいで推移
- 工場稼働率の低下と先行投資に伴う固定費率上昇により、利益は大幅な減益

単位:百万円	2023/3期					2024/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比	1Q比
売上高	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	<b>6,593</b>	△11.0	+2.6
売上総利益	1,155	1,017	1,231	695	4,100	722	<b>642</b>	△36.8	△11.1
販管費	619	615	655	648	2,538	590	<b>637</b>	+3.6	+8.1
営業利益	536	401	575	46	1,561	132	<b>4</b>	△98.8	△96.5
為替差損益	84	53	△80	△20	37	12	<b>16</b>	-	-
経常利益	638	489	516	161	1,805	162	<b>27</b>	△94.4	△83.0
四半期純利益	431	346	433	57	1,269	96	<b>△9</b>	-	-

# 製品群別四半期売上高(第2四半期)

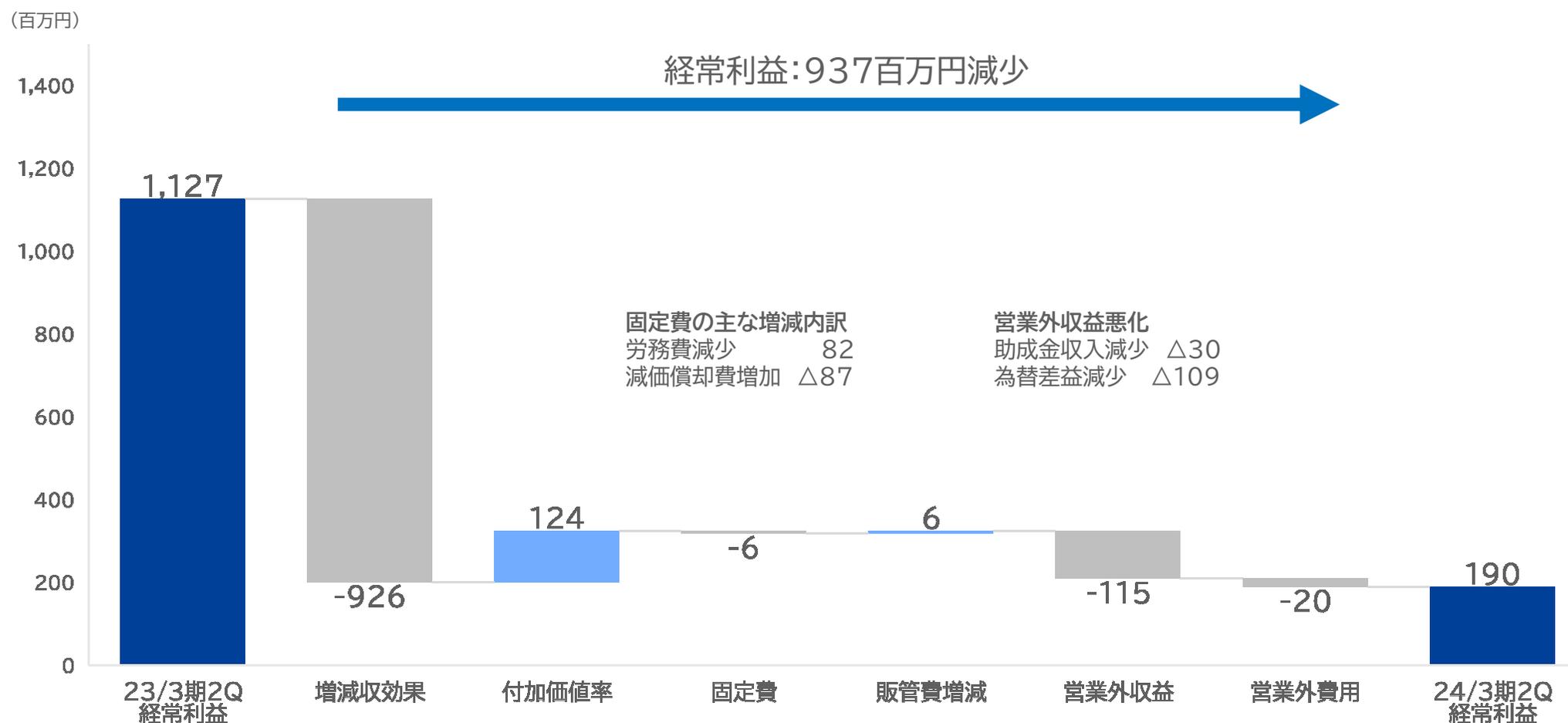
- ・ パワー半導体用リードフレームは、自動車向けが堅調に推移したが、民生・産機向けは在庫調整局面
- ・ オプト用リードフレームは、北米を中心に大型ディスプレイ向けが低迷し大幅減収
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向け、ウェアラブル向け共に在庫調整局面だが、1Q比では新機種向けで増加し車載(エアバッグ等)向けは回復基調に

単位:百万円	2023/3期					2024/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比	1Q比
パワー半導体用 リードフレーム	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	3,164	<b>2,832</b>	+1.2%	△10.5%
オプト用 リードフレーム	1,008	931	854	925	3,719	712	<b>662</b>	△28.9%	△7.0%
コネクタ用部品	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	2,437	<b>2,970</b>	△15.1%	+21.8%
その他	143	180	180	155	659	112	<b>129</b>	△28.2%	+15.6%
合計	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	<b>6,593</b>	△11.0%	+2.6%

- 増減収効果
- 付加価値率
- 固定費

パワー半導体用リードフレームは増加、一方コネクタ部品とオプト用リードフレームの販売が大幅減少  
クリップボンディングリードフレームの増加により製品ミックスは改善

- 生産能力増強に伴う減価償却費増加
- 稼働率低下により人件費、電力費は再エネ利用増と稼働率低下により減少



- ・ 車載はパワー半導体用リードフレームが好調、エアバッグ向けコネクタ等も回復基調
- ・ スマートフォンは前期4Qからの調整が続き、ウェアラブルも在庫調整
- ・ 民生・産機・その他はデータセンター向け等のパワー半導体用が調整、大型ディスプレイ向けのLEDも低迷

## 民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の34.2%から 3.5pt減少  
前年同期比24.2%減少
- ・ データセンター向け、産機向けのパワー半導体用  
リードフレームが在庫調整
- ・ 大型ディスプレイ向けのLED用リードフレームが  
減少

## ウェアラブル

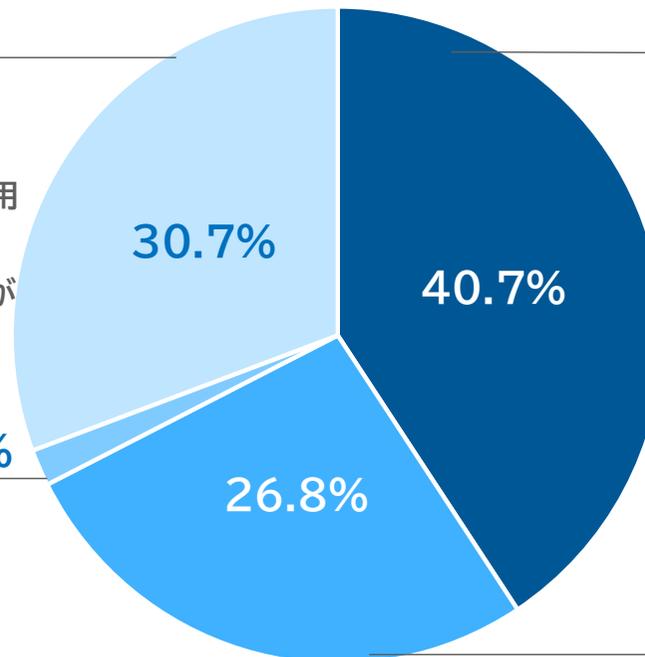
- ・ 構成比は前期の5.3%から 3.5pt減少  
前年同期比71.0%減少
- ・ ワイヤレスイヤホンやウォッチ向けの在庫調整

## 車載

- ・ 構成比は前年同期の32.8%から 7.9pt増加  
前年同期比5.1%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ エアバッグ向けコネクタ等が回復

## スマートフォン

- ・ 構成比は前期の27.7%から 0.9pt減少  
前年同期比17.9%減少
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の減少



- ・ 減収により売上債権や買入債務が減少
- ・ 1,044百万円のネットキャッシュ、自己資本比率は64.7%

単位:百万円	2023/3期末	2024/3期2Q末	前期末比増減
流動資産	19,051	17,800	△1,250
（内、現預金）	4,041	4,176	+135
（内、受取手形及び 売掛金及び契約資産）	8,617	7,295	△1,321
（内、たな卸資産）	5,720	5,365	△355
固定資産	14,988	15,058	+70
（内、有形固定資産）	13,501	13,521	+20
総資産	34,039	32,859	△1,179
負債	13,444	11,600	△1,843
（内、支払手形及び買掛金）	6,933	5,141	△1,792
（内、有利子負債）	3,132	3,132	+0
純資産	20,594	21,258	+663
負債純資産	34,039	32,859	△1,179

## (2)2024年3月期業績予想



- 下期回復を予想していたが、回復が来期に後倒しの見通しとなり売上高・利益とも下方修正
- 車載向けパワー半導体リードフレームは堅調だが、その他の製品群では調整が続く
- 工場稼働率低下に加えて、津軽工場などの先行投資負担もあり、営業利益率は大幅に低下  
新製品量産に向けての金型受注は好調なことから、調整明けには収益は回復に向かうと予想

単位:百万円	2023/3期実績		2024/3期				期比較	
	実績	売上比(%)	期初予想	売上比(%)	修正予想	売上比(%)	前期比(%)	修正比
売上高	29,265	100.0	29,000	100.0	25,000	100.0	△14.6	△13.8
売上総利益	4,100	14.0	4,300	14.8	2,850	11.4	△30.5	△33.7
販管費	2,538	8.7	2,600	9.0	2,550	10.2	+0.4	△1.9
営業利益	1,561	5.3	1,700	5.9	300	1.2	△80.8	△82.4
経常利益	1,805	6.2	1,700	5.9	350	1.4	△80.6	△79.4
当期純利益	1,269	4.3	1,250	4.3	250	1.0	△80.3	△80.0
1株当たり当期純利益	190.0円	-	187.1円	-	37.4円	-	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	70.0円	-	-	-

- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けが回復基調、民生・産業機器向けの在庫調整終了は4Q後半になる見通し
- ・ オプト用リードフレームは北米向け大型ディスプレイなどが低迷
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン、ウェアラブル端末向けの調整が後倒し、車載向けは回復基調

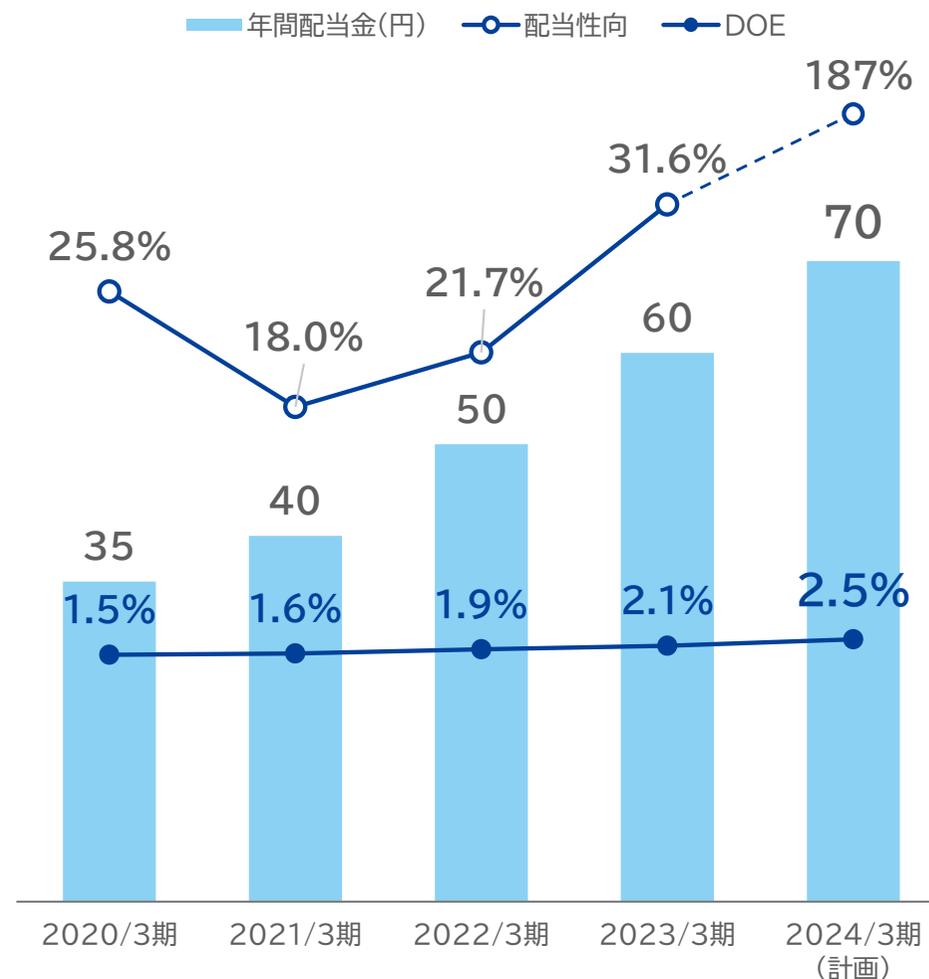
単位:百万円	2023/3期		2024/3期					
	実績	構成比(%)	期初予想	構成比(%)	修正予想	構成比(%)	前期比(%)	修正比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	12,500	43.1	<b>11,500</b>	<b>46.0</b>	△4.0	△8.0
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	3,800	13.1	<b>2,500</b>	<b>10.0</b>	△32.8	△34.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	12,000	41.4	<b>10,500</b>	<b>42.0</b>	△18.7	△12.5
その他	659	2.3	700	2.4	<b>500</b>	<b>2.0</b>	△24.1	△28.6
合計	29,265	100.0	29,000	100.0	<b>25,000</b>	<b>100.0</b>	△14.6	△13.8

- 2023年3月期はコネクタ用部品で津軽工場・中国子会社でのメッキ工程の生産設備を導入、パワー半導体用リードフレームは2nd STEPで計画していた中国子会社などへの増産投資を前倒しで実施
- 2024年3月期は海外工場のメッキ設備やコネクタ関係の金型投資を中心に24.8億円の設備投資を計画  
期初計画の16.8億円から増額

単位:百万円	2022/3期	2023/3期	2024/3期予想	前期比増減
設備投資	3,127	2,979	2,486	△493
パワー半導体用 リードフレーム	330	897	719	△178
オプト用 リードフレーム	111	307	130	△177
コネクタ用部品	2,384	1,136	1,258	+122
その他	301	637	377	△260
減価償却費	1,664	1,717	1,897	+180

- 2023年5月に配当方針をDOEをベースに変更、期初予想の70円配当を継続

- 配当金・配当性向の推移



## 2024年3月期以降の配当方針

- DOE\*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は70円配当を予想 (DOE2.5%)

\* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け  
次期中期経営計画「2nd STEP」での「1st STEP」数値目標達成を目指す
- 先行指標の金型受注は急増しており、足下の生産調整後の需要回復に大きな期待

<p>パワー半導体用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディング式リードフレームを拡販 ⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化</li> </ul>
<p>オプト用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 車載/民生向け部品のLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立（津軽工場を活用予定）</li> </ul>
<p>コネクタ用部品</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ</li> <li>• 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販</li> </ul>
<p>メッキライン(内製化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上</li> </ul>

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。